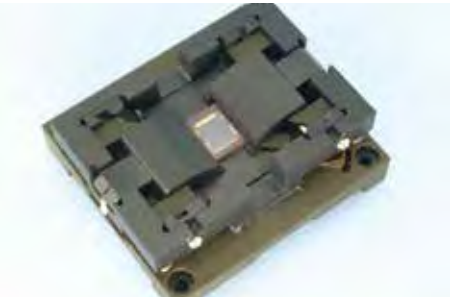




会社概要



株式会社 **SDK**
<http://www.ksdk.co.jp>

本 社

会 社 名	株式会社 SDK	従 業 員 数	50名
代 表 者	高田 昭人	本 社 住 所	〒244-0805
設 立	2006 年 2 月		神奈川県横浜市戸塚区川上町 90-6 東戸塚ウエストビル 7F
資 本 金	2 千万円	電 話 番 号	045-392-9937

板橋事業所

〒177-0041 東京都板橋区舟渡三丁目 5 番 8 号
板橋区立ものづくり研究開発連携センター 第一ビル 5-D 号室

韓国支社 海外支社

〒15850, 17, Gosan-ro 148beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea (B, #1904, Gunpo IT Valley)

SDK(广州) 貿易有限公司 関連会社

〒510000 中国广东省广州市天河区华穗路 406
号之二保利克洛维中景 A 座 A3103单元

こんな工程で、SDKがお役に立ちます

研究開発

設計 / 評価

工程設計

量産 / 品質保証

製品機能 / 特性確認

信頼性 / 限界試験

製品出荷検査 / 不具合解析

要素技術
先行開発

開発 / 技術

製造技術

品質保証

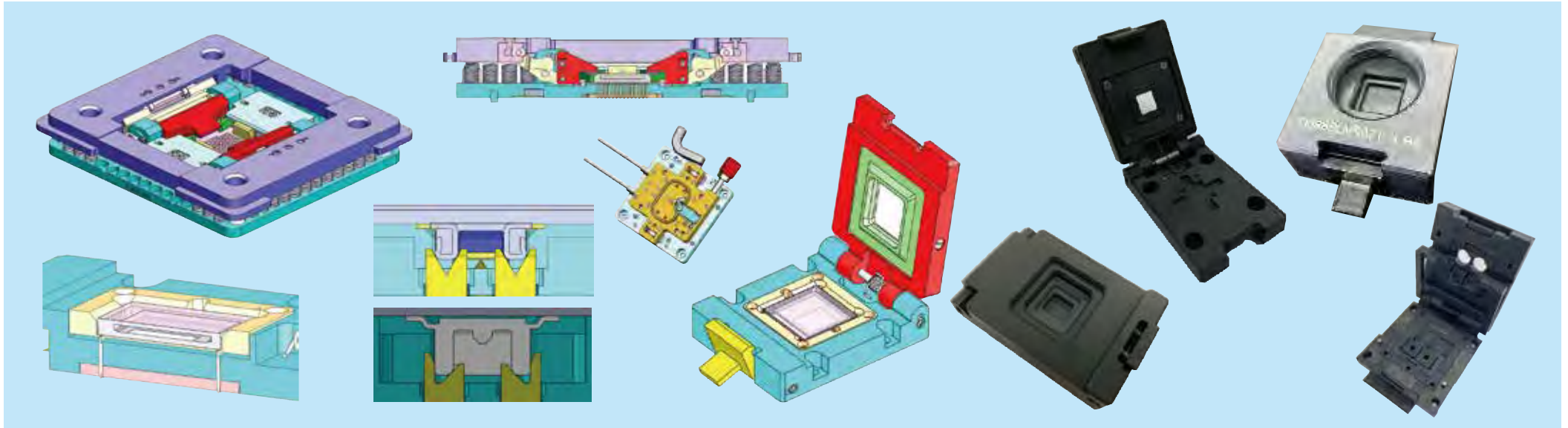
品質保証

テスト開発



1) CMOSセンサー CMOS sensor

04

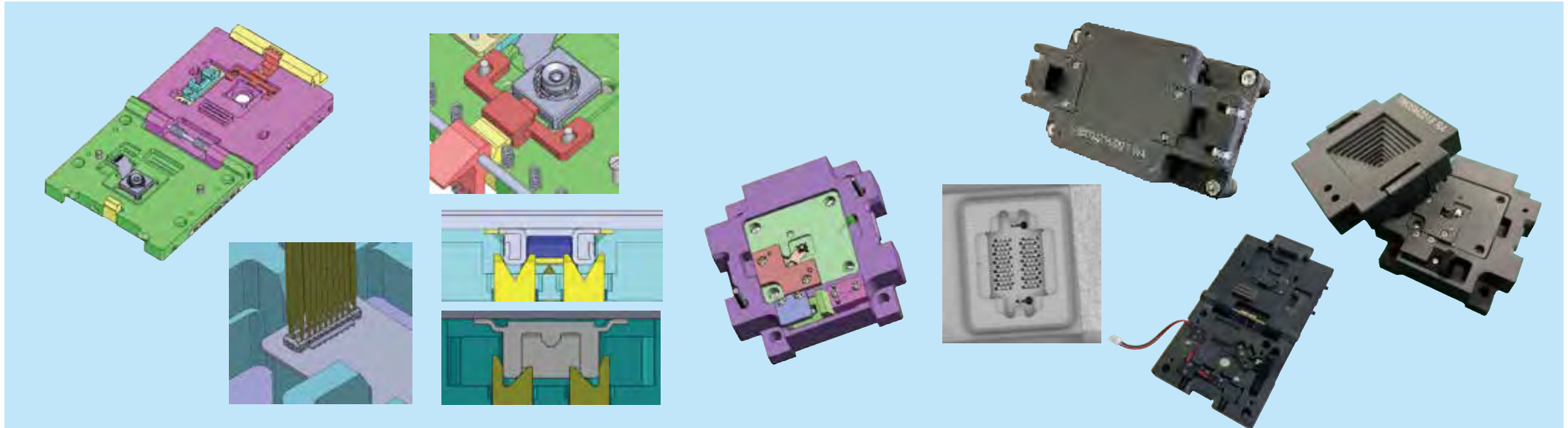


- ・ 様々なソケットタイプでの開発可能（クラムシェル / オープントップ / 分離タイプ）
- ・ センサー面に合わせた任意角度の光源開口部設置可能
- ・ 評価対象物のサイズに関係なく、適切な位置にセットする**位置補正機構**、**フローティング機構**の設置可能
- ・ 確実なコンタクトを実現する**特許取得の特殊先端形状プローブピン**の選択可
- ・ センサー面（ガラス面）を避けての押圧可能

2) カメラモジュール

Camera module

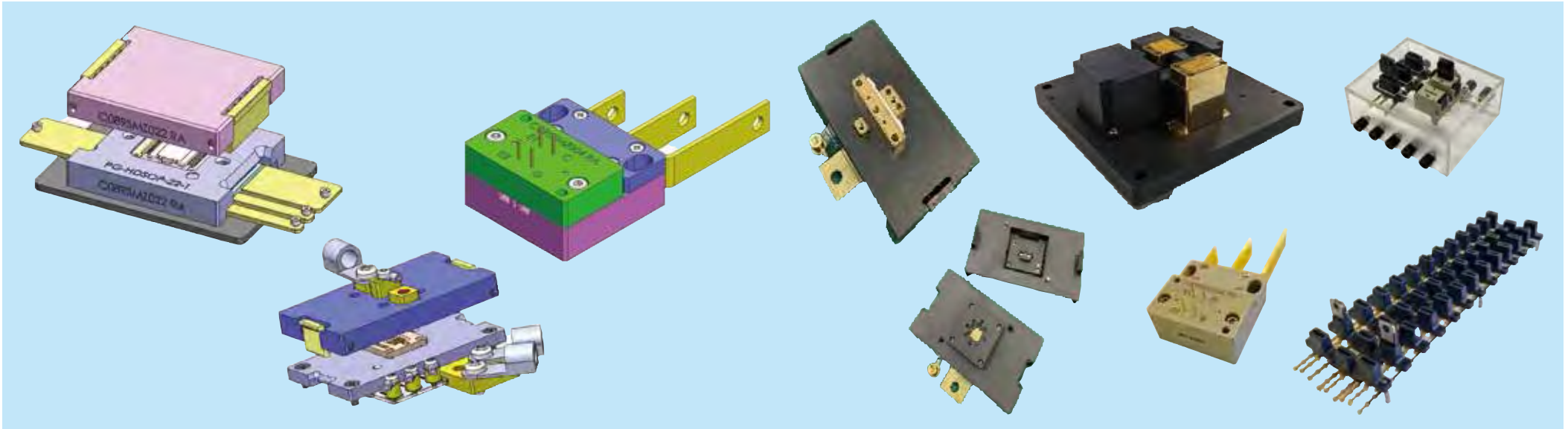
05



- ・評価対象物のサイズ、形状に関係なく、適切な位置にセットする**位置補正機構**
- ・**B to B コネクタへのコンタクト**
- ・確実なコンタクトを実現する**特許取得の特殊先端形状プローブピン**
- ・**狭ピッチ対応** (0.175mm 実現可 / 0.15mm ピッチ開発中)
- ・モジュールサイズ、荷重制限に応じた製品開発可

3) パワーデバイス Power Devices

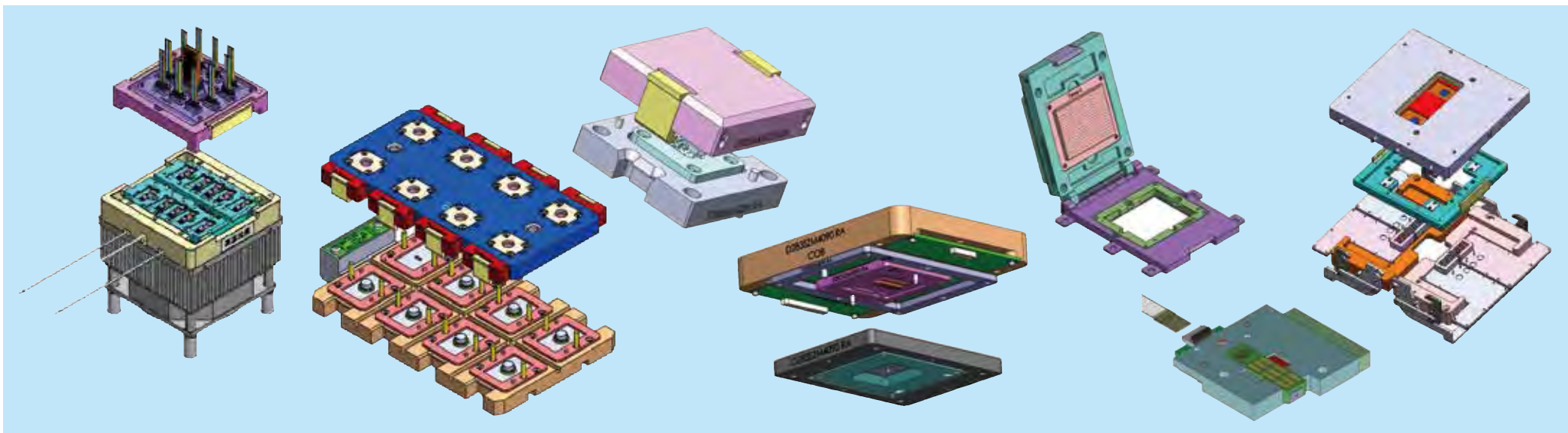
06



- ・ 様々な製品（モジュール、モールド、チップ）に対応
- ・ **大電流（最大 1,000A）、大電圧（5kv 以上）への対応**※使用条件による
- ・ 使用温度範囲**最大 200℃**への対応可※ご要望仕様に応じて 300℃対応可
- ・ 測定環境（装置）合わせた製品開発可能

4) 応用製品 Applied Products

07



- ・お客様の測定環境 / 仕様に合わせた製品開発（ペルチェシステム / ヒーター / 熱電対等の組み込み、複数個搭載など）
- ・ **特許取得の特殊先端形状プローブピン**などの採用による様々なコンタクト形状に対応（リード、スルーホール、パッド、BtoB コネクタなど）
- ・ 汎用製品にはない構成部品・ユニットでの購入 / 交換可。※部品交換手順書を準備可能
- ・ お客様の要望に合わせたカスタムメイドが可能。

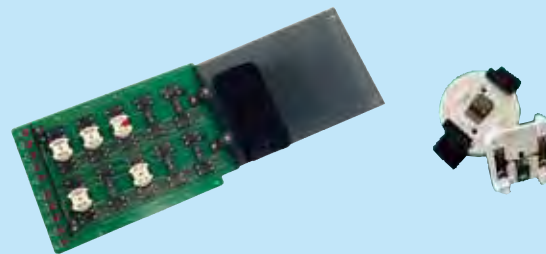
5) 応用製品開発事例

Application product development examples

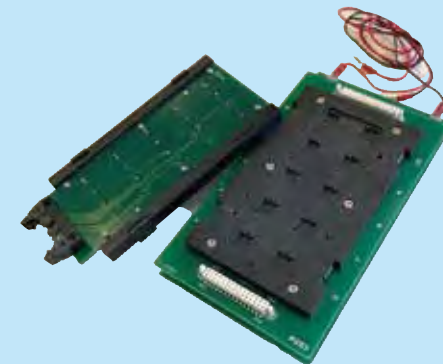
08



無線通信モジュール基板開発用ソケット



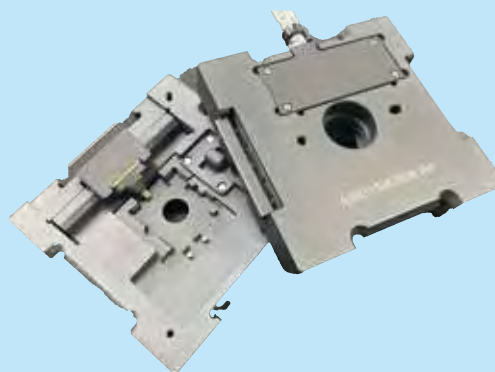
レーザーダイオードチップ
エージング用ソケット
(左：複数個搭載、右：ソケット)



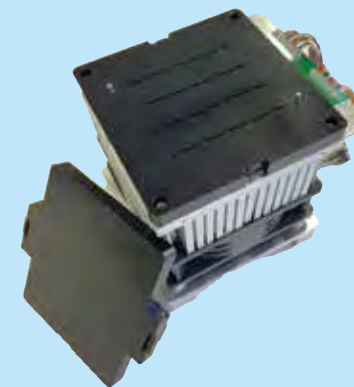
レーザーダイオード (CAN) 用エージングソケット



クリップ型コンタクトソケット



ショート動作確認用ソケット



ペルチェ付 / 複数個搭載 LED エージングソケット

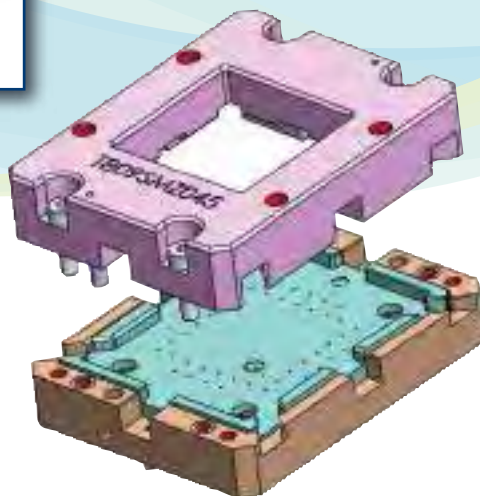
掲載製品は、開発製品の一例です。ぜひ気軽に問い合わせ下さい。

6) 研究開発協力

Research and development collaboration

09

大阪大学様からの依頼に基づき、SDK ソケットを採用頂きました。



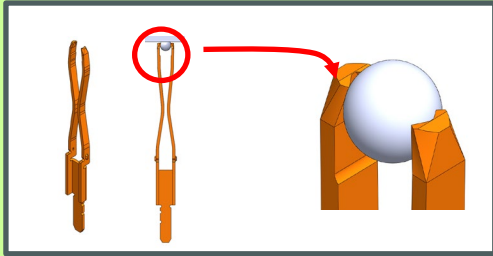
Pin洗浄可能なBIソケット「あえるBI」 誕生！

特許第7465028号取得

あえるびーって呼んでね！

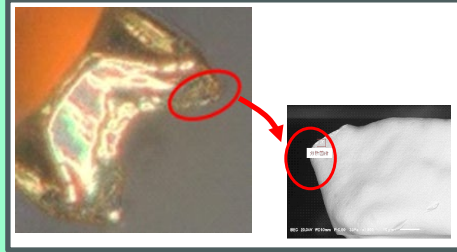
特殊先端形状

- ✓はんだ転写しにくく、安定したコンタクトを実現
- ✓PKG上面解放(押圧不要)での検査が可能



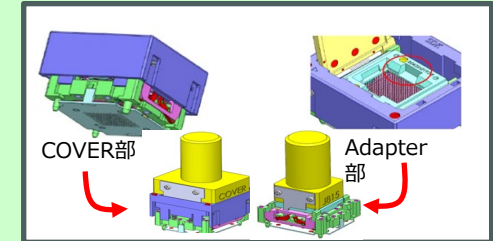
低接触抵抗

- ✓様々なメッキ（材質/厚みなど）を比較検証
1Ω以下の接触抵抗を実現
- ✓安定したコンタクト状態の長期化

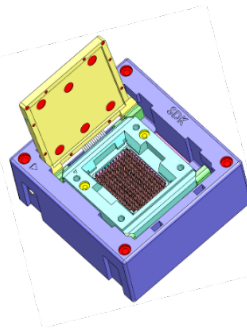
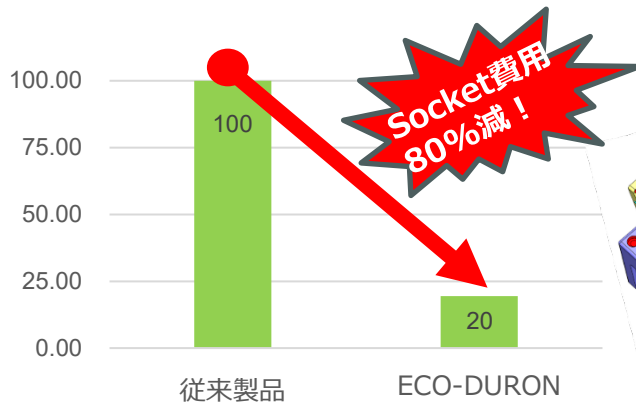


Repair

- ✓これまでのBI SocketにないPin洗浄可能な構造を実現
- ✓分解/組立て治具も同時に開発
(分解/組立ては各1分以内で可能)



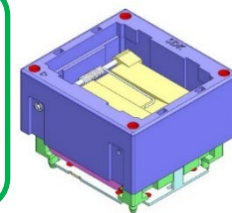
ソケット寿命爆延



Pin洗浄がカンタンにできる



だから
作業性



Socket本体廃棄不要

だから



- ・コンタミ対策用に蓋を装備。蓋はバーンイン層内の温風風力を考慮
- ・JIS-C-7022規格試験(メッキ/Pinハンダ 付着性+ハンダ 耐熱性,メッキ/Pin温度サイクル,Pin熱衝撃,メッキ/Pin高温保存,端子強度) クリア
- ・MIL-STD規格準拠フロー：10Set繰り返し温度サイクル(150℃30H高温保存,150℃ハンダ付着性/ハンダ耐熱性)クリア

7) ソケットだけじゃない SDK

10



高速デジタル回路基板



アナログ高周波アンテナ基板



アナログ 高周波

多彩な基板材料に対応
ハイブリッド基板にも対応可能
50GHz 帯基板設計・制作の実績



高速 デジタル

DDR4、PCIe-gen3 を含む CPU
基板設計・製作
DDR4×32 個の基板設計・制作の実績



電源

(パワーエレクトロニクス)

基板材料銅箔厚み最大 70 μ m 対応
最大 400 μ m の厚銅基板対応可
MHz 帯電源基板設計・制作の実績



高い 対応力

スケジュール・コスト
性能・デザイン性
お客様の要求を実現



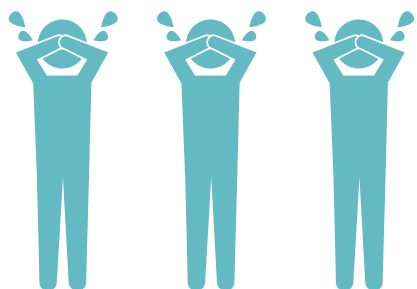
品質・環境への 取り組み

ISO9001 認証
ISO14001 認証
環境マネジメントシステムの策定・実施

ハイエンドな基板設計・製作ならSDK

11

パートナーを選ばないと
回路は動かない



電子回路の高速化、高周波化、ハイパワー化が進む現在、回路の動作は次工程である基板設計にかかっています。ハイエンドな電子回路設計には、基板に関する経験と、データの蓄積が十分あるパートナーが必要です。

ドローン用リモコン向け 2.4GHz 帯プリント八木アンテナの基板
ドローン用（プロポ）向け 1.2GHz 帯プリント八木アンテナの基板
レーダー信号処理回路の基板（3GHz ~ 18GHz）
レーダー用送受信パッチアレーアンテナの基板（10GHz 帯）
レーダー用送受信プリント八木アンテナの基板（950MHz 帯）
シート状パッチアンテナの基板（2.4GHz 帯 5.2GHz 帯用）
ラジアルラインマイクロストリップアンテナアレー基板（12GHz）
変調および復調回路の基板（1KHz~1GHz）
アップダウンコンバータの基板（3GHz~26GHz）

SDK は基板設計・製作経験
30 年以上



SDK の基板設計部門は、30 年以上の経験とデータの蓄積がある専門家集団です。
高周波・高速デジタル・電源基板の設計・製作で圧倒的な実績があります。

USB3.0 を使用した基板
PCIe_gen3 を使用した基板
DDR4_2400 を 32 個搭載した基板
DDR3_1600 を 16 個搭載した基板
DDR2_800 を搭載したモバイルアクセサリの基板
DDR2_800 を搭載した高速応答タイプ電源の基板
FPGA・PLD・DSP を使用した高速信号処理の基板
大規模 BGA・FPGA・PLD・DSP を使用した高速号処理の基板

だから…



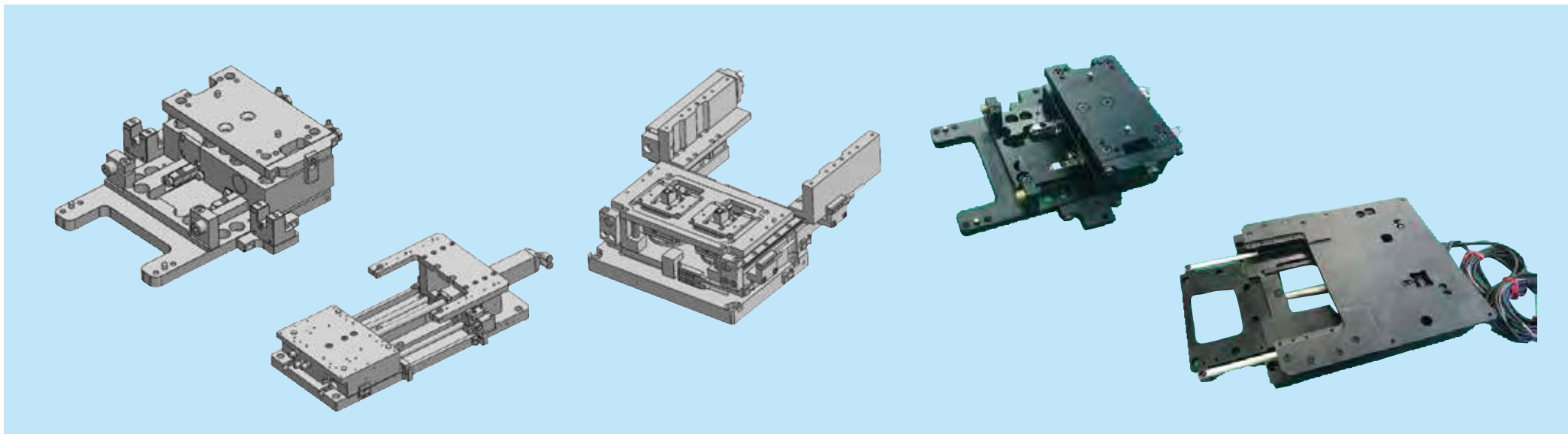
**ハイエンドな
基板設計は
当社にお任せください**

ドローン用リモコン向け 2.4GHz 帯プリント八木アンテナの基板
ドローン用（プロポ）向け 1.2GHz 帯プリント八木アンテナの基板
レーダー信号処理回路の基板（3GHz ~ 18GHz）
レーダー用送受信パッチアレーアンテナの基板（10GHz 帯）
レーダー用送受信プリント八木アンテナの基板（950MHz 帯）
シート状パッチアンテナの基板（2.4GHz 帯 5.2GHz 帯用）
ラジアルラインマイクロストリップアンテナアレー基板（12GHz）
変調および復調回路の基板（1KHz~1GHz）
アップダウンコンバータの基板（3GHz~26GHz）

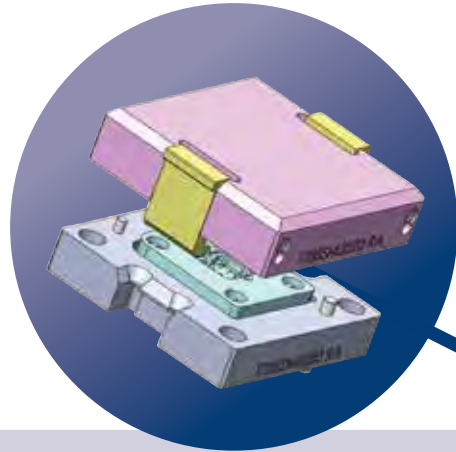
その他技術情報、実績紹介、公開論文などは当社 Web サイトへ
<https://www.ksdk.co.jp/link/openreport.php>

8) アクチュエーター Actuator

12

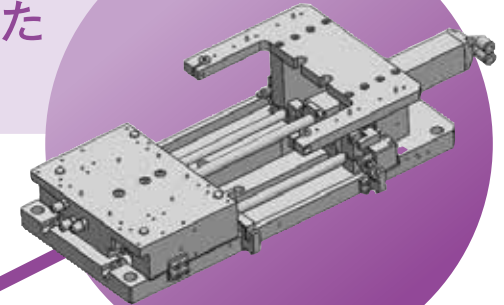


- ・ 様々なサイズとストロークの充実した製品ラインナップ
- ・ 電動、エア共に対応可
- ・ クロスローラーガイド採用により精密な移送が可能
- ・ 材質はアルミ、真鍮、ステンレスなど様々な材質に対応可
- ・ **設備に合わせ、サイズ、精度、剛性など要望に応じ、更には SDK ソケットに合わせた製品開発が可能**

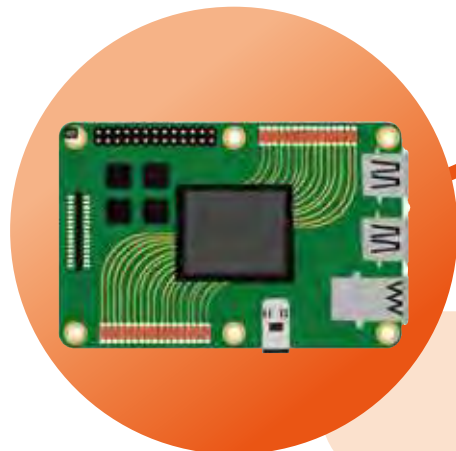


お客様の評価対象製品
用途に合わせたソケット製品

お客様の装置に合わせた
アクチュエータ製品



**「お客様の製品と
装置を結ぶ」
SDKにお任せ下さい。**



お客様の仕様に合わせた I/F を持つ
中継基板製品